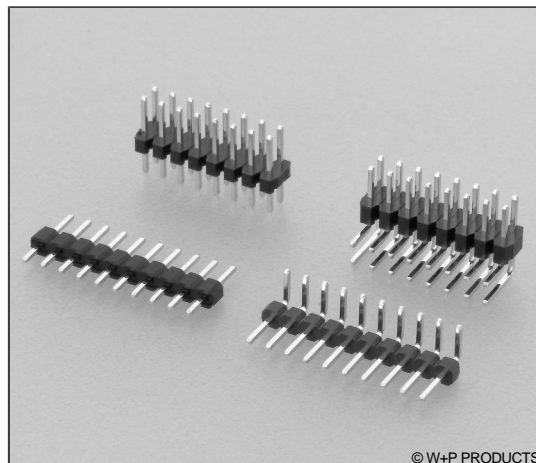


## Stiftleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt, 1-/2-reihig Pin Headers, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled, Single/Double Row

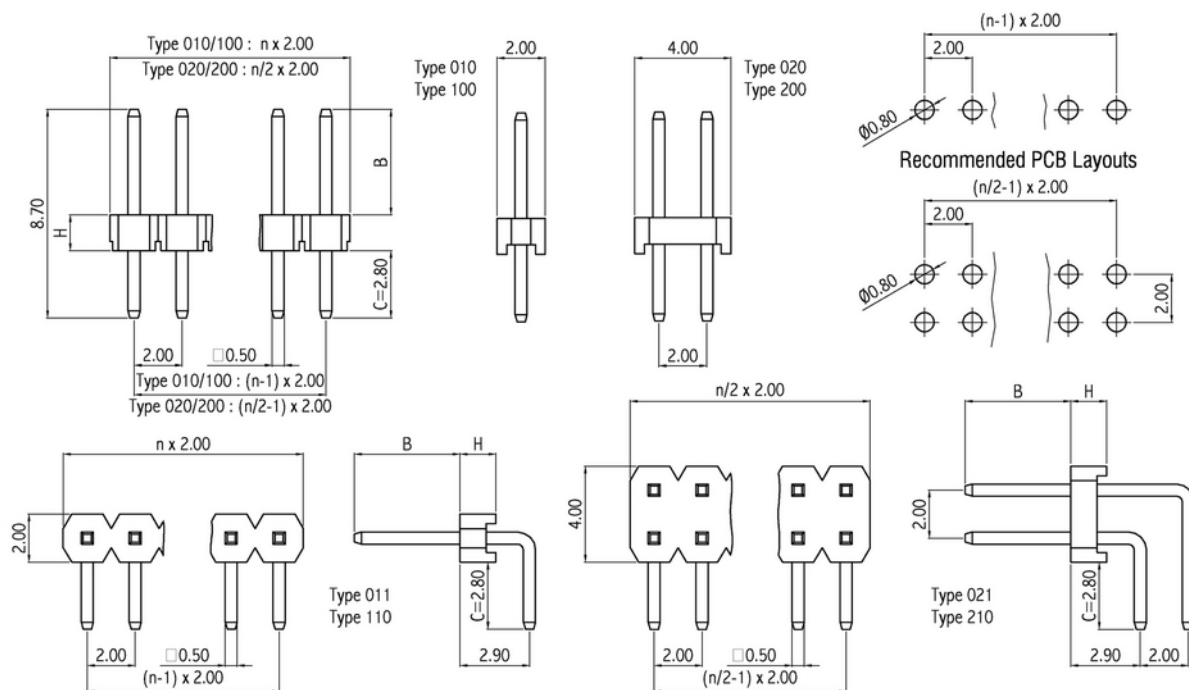
### Technische Daten / Technical Data

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Isolierkörper         | Thermoplast, nach UL94 V-0                           |
| Insulator             | Thermoplastic, rated UL94 V-0                        |
| Kontaktmaterial       | Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung                |
| Contact Material      | 0.50mm square pin, copper alloy                      |
| Kontaktoberfläche     | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)     |
| Contact Surface       | Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm) |
| Durchgangswiderstand  | < 20 mΩ  |
| Contact Resistance    | < 20 mΩ  |
| Isolationswiderstand  | > 1000 MΩ  |
| Insulation Resistance | > 1000 MΩ  |
| Spannungsfestigkeit   | 1 kV DC  |
| Test Voltage          | 1 kV DC  |
| Nennspannung          | 250 V AC   |
| Voltage Rating        | 250 V AC   |
| Nennstrom             | 1 A  |
| Current Rating        | 1 A  |
| Temperaturbereich     | -40 °C ... +125 °C                                   |
| Temperature Range     | -40 °C ... +125 °C                                   |
| Verarbeitung          | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren                     |
| Processing            | Wave or reflow soldering                             |



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Compatible Female Headers:  
**316 744 416 518 (Crimp)** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
Please see ch. B for more



### Series

**314**

314 Gestanzte/geprägte Kontakte  
Stamped/formed contacts

### Type\*

**011**

**010/020** Gerade H=2,00 B=3,90mm  
Straight H=2.00 B=3.90mm  
**100/200** Gerade H=1,50 B=4,40mm  
Straight H=1.50 B=4.40mm  
**011/021** Gewinkelt H=2,00 B=3,90mm  
Right-angled H=2.00 B=3.90mm  
**110/210** Gewinkelt H=1,50 B=4,40mm  
Right-angled H=1.50 B=4.40mm

### Contacts\*

**040**

**001-040** Einreihig  
Single row  
**002-080** Zweireihig  
Double row

### Plating\*

**60**

**00** Vergoldet  
Gold plated  
**50** Verzinkt  
Tin plated  
**60** Sel. Au/Sn  
Duplex plating

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.  
Raster 4,00mm, 6,00mm, etc. oder Sonderraster auf  
Anfrage. Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten"  
unter Techn. Informationen.  
We will manufacture the pin headers in every desired  
number of contacts. 4,00mm, 6,00mm, etc. and other  
itches by request. Order page "Customer-specific Pin  
Configurations" in Technical Information.

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



### Reflow-Lötempfehlung

*Reflow Soldering Recommendation*

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert      |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150 °C        |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200 °C        |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60 – 180s     |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | 217 °C        |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | 60 – 180s     |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur $T_P$               | 260±5 °C      |
| Dauer Höchsttemperatur               | 20 – 40s      |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s      |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$ | max. 8m       |

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).*

| Profile Feature                      | Key Values    |
|--------------------------------------|---------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150 °C        |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200 °C        |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60 – 180s     |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | 217 °C        |
| Duration above $T_L$                 | 60 – 180s     |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3 °C / s |
| Peak Temperature $T_P$               | 260±5 °C      |
| Duration Peak Temperature            | 20 – 40s      |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s      |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | max. 8min     |

